

株式会社東京精密 2021年度(2022年3月期)第2四半期決算説明会

質疑応答 要約

2021年11月2日 開催

- 本資料は、上記日時に開催された2021年度(2022年3月期)第2四半期決算説明会(Web開催)の質疑応答の内容を、当社の判断で要約したものです。
- 本資料に記載されている情報は、決算説明会開催日時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。
- なお、本資料では、半導体製造装置(または同セグメント)を「SPE」、精密計測機器(同左)を「計測」、ディスプレイドライバICを「DDIC」と表記します。

1. 現在のSPE市場の景況感と、今後の見通しについてコメントが欲しい。

- 現在、従来の欧米顧客中心の市場と、中国の市場、2つが存在している。前者では通信やパワー半導体などの需要を主因として、先を見据えたSPEの発注がされている状況。中国市場では全てのデバイスで堅調な引き合いがある。
- 製品の出荷納期が長くなっているため、2021年度下期に踊り場的な調整ならびに出荷納期が落ち着き需要が戻る、との想定を持っている。
- 一部後工程装置のキャンセル、メモリスポット価格下落、TV用DDICの余剰感など、一定のネガティブな情報があることは承知している。しかし、下期のSPE受注見通しはアップサイドの余地があると考えている。DDICではTV用途が減少する一方、より検査時間を必要とする車載用が拡大し、プローバ・ダイサの需要に繋がる可能性もあり、SiC関連、Mini LED関連の需要も増加していることがその根拠である。

2. 半導体製造装置統計によれば、2021年8月-9月にかけて「その他地域」でプローバ売上のキャンセルがあったと見受けられるが、これについてコメントが欲しい。

- 当社においてキャンセルは一切発生していない。

3. 仮にSPE需要に調整が発生するとすれば、どのような要因が想定されるか?

- 先ほど述べた米国の通信関連需要の納期観点での調整、ならびに中国の財政的なリスクを遠因とした調整、などを想定している。

4. SPE業界がかつてない活況を呈している中、中国案件のキャンセルリスクについて、当社はどのような対策をとっているのか?

- ローカルの中国顧客の場合、例えば3割の前受金を受領した時点で生産を開始、全額入

金を以て輸出するなどの措置をとっている。

- 9月末時点の前受金は60億円程度となっている。

5. 現在のSPE製品納期について聞きたい。

- 製品仕様があるので一般的な話となるが、いま注文を頂くと、プローバは2022年6月、ダイサは同7月後半-8月頃。研削装置はもう少し長い納期となる。

6. 世界的に部材調達がタイトになっている。当社において、特に不足している部材、生産対応の状況、ならびに今期の業績予想に対する材料確保状況を聞きたい。

- 半導体デバイスそのものに加え、樹脂を使ったコネクタ等で生産地域が東南アジアにあるもの。ロックダウンにより生産停止した影響が非常に大きい。
- 調達に大変苦労しているが、代替品を探しそれに合わせて設計変更を行うなど、生産に遅れが生じないように対応している。毎日設計変更に追われる技術人員の苦勞で何とか対応できている。
- 在庫確保については、部品により異なるので一概には言えない。ただ、タイトな部材によっては、販売元から2021年度分の納期の確約が得られないものもある。

7. 物流面でも相当タイトではないかと考えられる。当社における状況、ならびに今期の業績予想におけるバッファについて聞きたい。

- 2021年度上期、特に9月は、航空便・船便の確保ができなかったことや、COVID-19による顧客サイトのロックダウンにより、売上が社内計画に対し20億円ほど下振れた。
- 中国向け、特に大型のSPEについては、下期の物流リスクを強く警戒している。
- 詳細な数字開示は控えるが、下期予想に物流リスクを一定程度織り込んでいる。

8. SPE 消耗品について 現在の売上水準や、装置同様、供給の状況を確認したい。

- ダイシングブレード事業は、大きな変化は無く事業譲受時点の3倍強の売上水準。研削装置消耗品の販売が増加し半期10億円を超え、消耗品全体で年間50億円程度の売上規模となっている。
- 消耗品類の出荷も、装置同様逼迫している。さらに、メッキ材料の供給リスク(中国の電力不足による間接的な影響で黄燐が不足する)は非常に心配している。

9. 計測における充放電試験システム事業、SBS バランサ事業の現況を聞きたい。

- 充放電試験システム事業については、受託試験の需要は増加、2022年度以降も増加を見込んでいる。一方で機器販売は、日本国内のEVバッテリー生産ラインの立ち上がりはまだ準備に段階あるため、話材はあるが拡大までにもう1,2年は要する状況。いずれにしても2,3年のスパンで業容を見ていきたいと考えている。
- SBS バランサ(研削盤に搭載する砥石のバランスをとる)は、高精度研削盤需要が大きい欧州や中国で主要顧客からの注文を増やして順調に推移、受注回復の一因になっている。

10. 計測における ドイツ JENOPTIK 社製シャフト測定機の販売・サービス提携基本合意について、目的・期待される売上規模などを聞きたい。

- 一般的に シャフト等 軸物の測定には接触式の真円度測定機が用いられるが、ここで非接触測定へのニーズが上がっている。このため、非接触シャフト測定においてドイツで高シェアを有する JENOPTIK 社とタイアップし、販売することとした。売上規模は 10 億円程度と想定しているが、先般 展示会で参考出品したところ、好感触を得られたので、次回の説明会でもう少し具体的な話ができる可能性がある。

11. 2021 年度下期の修正後業績予想では、営業利益率が上期対比で低下する計画となっている。この要因と、セグメント別の影響を聞きたい。

- 部材の値上げ影響(5 億円程度)について、売上規模に応じ SPE に大きな影響を見ているが、計測にも一定の影響を織り込んでいる。このほか、SPE の生産拡大に伴う外部倉庫賃貸料の増加がある。減価償却費・人員増加・輸送コスト増加なども織り込んでいる。
- なお、計測事業については、下期の営業利益率は上期対比で改善を見込んでいる。

12. SPE の生産能力について、具体的にどのような施策により増やしたのか確認したい。また、下期の売上予想に対してはどうか、さらに飯能工場の稼働前までの生産能力について考えを聞きたい。

- 現時点で、SPE の生産能力を 2020 年度比で約 40%程度 増やした。大きな施策は、① 土浦工場内の MI 棟の活用、②八王子工場近辺で倉庫を借り、部材を移すことによる工場生産スペースの拡大。下期 SPE 売上予想修正は、②の要因が大きい。なお、各施策は、稼働してすぐに最大の効果がでるものではなく、段階的に増えるものである。
- 2022 年度(飯能工場の稼働まで) の生産能力拡大については、当社グループ内ファシリティを活用し生産のバックアップをしていく方向で、具体的には名古屋にあるグループ内工場の活用準備を始めている。名古屋工場がフルに活用された場合、生産能力を半期 30-40 億円増やせる可能性がある。

13. 改めて SPE が活況であると認識する。そんな中、半導体後工程では、デバイスの個数成長以外の需要が増加しているのか? そうならばその要因は何か?

- 例えばブレードダイサであれば、ウェーハだけではなく、QFN や BGA のようにパッケージそのものを切る需要が増加しているし、研削装置であれば SiC などの難削材研削需要が増加し、その分必要台数が増加している、という事は言える。
- こういった技術革新投資が、当社 SPE の需要調整が起こらない背景かもしれない。

14. 当社の利益率を他 SPE 企業と比較すると差異が見られる。これに対する現時点での問題意識や、次期中期目標における改善手段などについてコメントが欲しい。

- 営業利益率は一定の水準には達していると思うが、生産拡大の一環で外部倉庫の借用、

倉庫・工場間の輸送コストなどの費用が生じているのも事実である。飯能工場稼働の折には、こういったコストは削減され、売上総利益ベースでは改善すると考えられる。あとは部材コストの上昇とのバランス次第ではないかと考えている。

以上